ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการกัดเพื่อหา พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการผลิตหัวอ่าน-เขียน ฮาร์ดดิสก์

ผู้เขียน นางสาวอลงกต ลิ้มเจริญ

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. คมกฤต เล็กสกุล

บทคัดย่อ

ในกระบวนการกัดชิ้นงานของการผลิตหัวอ่าน -เขียนฮาร์ดดิสก์ เป็นกระบวนการผลิตที่ จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็น การกัดโดยใช้หลักการการแตกตัวของไอออน นอกจากนั้นแล้วใน ส่วนของต้นทุนของวัสดุที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาสูงมากเช่นกัน ทั้งนี้ในการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ นั้น มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งทางบริษัทเองยังไม่มีข้อกำหนดหรือองค์ ความรู้ในการปรับสภาพที่เหมาะสมของกระบวนการ ปัจจุบันหากแต่ใช้การทดลองสุ่มปฏิบัติและ ใช้ประสบการณ์รวมถึงคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่อง เพื่อให้ได้หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ตามที่ลูกค้ากำหนด

ปัญหาดังกล่าว มีความสำคัญ โดยตรงกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง ได้ตระหนักถึงปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดย เริ่มจากการออกแบบการ ทดลอง (Design of Experiments; DOE) เพื่อหาพารามิเตอร์ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ กระบวนการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ และทำการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตมากที่สุด หลังจาก นั้นทำการทดลอง โดยใช้ โปรแกรมการจำลองสถานการณ์การผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ สร้าง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบการถดถอยแบบหลายตัวแปร ที่ใช้สำหรับการพยากรณ์ผลตอบ และทำการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละพารามิเตอร์ เมื่อ ได้สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ ทำการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ตามสภาวะที่เหมาะสมที่สุดแล้ว จึงนำสภาวะที่เหมาะสมที่สุดมา

ทดลองใช้กับวิธีการผลิต ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้จะสามารถช่วยลด ระยะเวลาการผลิต เพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์หัวอ่านฮาร์ดดิสก์

โดยเงื่อนไขที่ดีที่สุดของการกัดด้วยเครื่อง RIE ที่ทำให้มีค่ามุมเท่ากับ 60° และค่าความลึก เท่ากับ 2.5 μm คือ Pressure = 3.6 mTorr, Coil Power = 326 Watt และ Platen Power = 267 Watt ซึ่งจากเงื่อนไขดังกล่าวค่ามุมจะเท่ากับ 60.08° และความลึกจะเท่ากับ 2.36 μm ซึ่งผลที่ได้จากการ ทดลองด้วยเครื่อง RIE นั้น วัดค่ามุมได้ 60.83° และความลึกได้ 2.32 μm ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจาก ค่าที่คำนวณจากการหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดคิดเป็น 1.25% ของผลตอบมุม และ 1.69% ของผลตอบ ความลึก ส่วนผลที่ได้จากการทดลองด้วยโปรแกรมจำลองกระบวนการกัด วัดค่ามุมได้ 62.54° และ ความลึกได้ 2.39 μm มีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่คำนวณจากการหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดคิดเป็น 4.08% ของผลตอบมุม และ 1.27% ของผลตอบความลึก และค่าความคลาดเคลื่อนของผลที่ได้จากการ ทดลองด้วย โปรแกรมจำลองกระบวนการกัด มีความคลาดเคลื่อนจากผลที่ได้จากการทดลองด้วย เครื่อง RIE คิดเป็น 2.79% ของผลตอบมุม และ 3.01% ของผลตอบความลึก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

To MAI

Thesis Title Application of Statistical Technique in Etching Process

Parameter Optimization for HDD Slider Fabrication

Author Ms. Alonggot Limcharoen

Degree Master of Engineering (Industrial Engineering)

Thesis Advisor Asst. Prof. Dr. Komgrit Leksakul

Abstract

In the etching process of Slider Fabrication by using the reactive ion etching to etch on wafer surface needs advanced technology. Besides, the cost of raw material is somewhat costly. Seemingly, there are many factors affecting the quality of Slider Fabrication during its production process. The company still, somehow, lacks of certain specification and standard procedure to adapt the manufacturing process. The company experiences this technology both by doing and from machine supplier, thus being able to respond to customers' needs.

Realizing that the problem has such direct impact to the manufacturing process of Slider Fabrication and its quality, this paper is therefore aimed to discuss solutions. The method began with the consideration of influencing factors that cause defectiveness in production process. The Design of Experiments (DOE) was use as a tool to identify parameters. Then, the most promising parameters to the production process were selected and run experiment by using the mathematical model for Slider Fabrication production. To model the relationship between the parameters and responses based on the significant factors using ANOVA. Secondly, the optimization technique is adopted to the final mathematical model based on DOE to find the proper condition will be

confirmed in the real process. This solution is believed to cut the production time, to improve the manufacturing efficiency as well as to improve the product quality of Slider Fabrication.

The optimal condition for RIE etching (Wall = 60° and Depth = $2.5~\mu m$) is Pressure = $3.6~\mu m$ Torr, Coil Power = $326~\mu m$ Watt and Platen Power = $267~\mu m$ Watt. From this condition, wall angle is 60.08° and depth is $2.36~\mu m$. These errors are 1.25% of wall and 1.69% of depth responses. After, we conducted the experiment with RIE machine, we found that the results are 60.83° and $2.32~\mu m$ and these errors are about 4.08% of wall and 1.27% of depth responses. From the simulation, the results are 62.54° and $2.39~\mu m$ with errors are about 2.79% of wall and 3.01% of depth responses.

